

证券代码:000701

证券简称:厦门信达

公告编号:2020-24

厦门信达股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王福顺:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 年初至报告期末, 本报告期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

注:上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期内归属于永续债持有人的利息34,451,850.00元,扣除永续债利息后,归属于上市公司普通股股东的净利润为-32,769,224.40元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债利息的影响。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及扣除非经常性损益后的净利润计算的公司经常性损益项目,与《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形,说明理由
□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况, etc.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量, etc.

前10名股东参与融资融券业务情况(如有)
说明:前10名大股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项
一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 增减. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 衍生金融资产, etc.

重要事项
1、本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是上年度期末资金回笼,保障经营发展的资金需求;
2、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是结构性存款等债务工具投资增加;
3、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是期货和外汇衍生品公允价值变动;
4、本报告期末应收账款较上年度期末减少主要是商业承兑汇票到期托收;
5、本报告期末预收账款较上年度期末增加主要是本期供应业务预收账款未到期结算;
6、本报告期末其他流动资产较上年度期末减少主要是本期用以摊成本计量的结构性存款;
7、本报告期末其他非流动资产较上年度期末增加主要是本期新增福建省平潭县信保中心合伙企业(有限合伙)等不具有重大影响的股权投资;
8、本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是业务发展增加增加银行借款;
9、本报告期末交易性金融负债较上年度期末减少主要是借出资金租赁合同到期;
10、本报告期末预收账款较上年度期末减少主要是根据新收入准则,对部分预收款项重新分类列报至合同负债,其他流动负债等项目;
11、本报告期末合同负债较上年度期末增加主要是根据新收入准则,对部分预收款项重新分类列报至合同负债;
12、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是绩效工资发放;
13、本报告期末应交税费较上年度期末增加主要是计提企业所得税;
14、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是根据新收入准则,对部分预收款项重新分类列报至合同负债;
15、本报告期末资产减值损失较上年度期末减少主要是根据新收入准则,对部分递延收益重新分类列报至合同负债;
16、本报告营业收入较上年同期减少主要是供应链业务规模缩减;
17、本报告营业成本较上年同期减少主要是供应链业务规模缩减,成本相应减少;
18、本报告营业税金及附加较上年同期减少主要是大宗贸易业务规模缩减,对营业税金及附加相应减少;
19、本报告期间财务费用较上年同期增加主要是本期人民币贬值汇兑损失增加;
20、本报告期间投资收益较上年同期增加主要是本期处置金融资产取得收益增加;
21、本报告期间资产减值损失较上年同期增加主要是本期大宗商品行情下跌,存

货跌价准备增加;
22、本报告期间资产处置收益较上年同期减少主要是本期处置资产收益减少;
23、本报告期间经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少;
24、本报告期间筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期借款收到的现金减少以及偿还债务;
25、本报告期间汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是本期汇率变动。

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

股份回购的实施进展情况
□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况
□适用 √不适用

单位:元

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 最初投资成本, 会计减值准备, 期末账面价值, 公允价值变动损益, 本期公允价值变动损益, 报告期损益, 期末公允价值, 会计减值准备, 资金来源.

注:1、实际募集资金总额扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,278,147,028.63元,已于2016年1月26日到位,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了【2016】京会验字(2016)第0200007号验资报告。

(二)募集资金使用及节余情况
截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

Table with 7 columns: 项目名称, 专户银行名称, 初始存放金额, 利息收入, 现金留存, 已使用金额, 补充流动资金, 节余金额.

注:1、补充流动资金中已使用金额超出初始存放金额部分的55.00元为支付银行帐户管理费形成,存储余额22,112.67元为募集资金产生的利息,已于2020年1月31日前全部转入一般帐户使用。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和交易所要求,结合实际情况修订了《募集资金使用管理制度》。

2016年1月9日,公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日,募投项目实施主体、公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议》(范本)不存在差异。截至2019年12月31日,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金余额为22,112.67元。

单位:元

Table with 5 columns: 专户银行名称, 账号, 余额, etc.

注:截至2019年12月31日,2015年非公开发行股票募集资金使用完毕,存储余额22,112.67元为募集资金产生的利息;截至2020年1月31日,2015年非公开发行股票募集资金专户余额全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(一)募集资金使用计划变更情况
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。

(三)募集资金投资项目实施方式变更情况
不适用。

(四)募集资金先期投入及置换情况
(五)募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用。

(六)募集资金投资项目实施主体变更情况
(七)募集资金投资项目实施主体变更情况
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截至2019年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项,募集资金余额22,112.67元已于2020年1月31日前全部转入一般帐户使用。

(九)募集资金使用其他情况
本报告期,公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

4、变更募集资金用途使用情况
(一)变更募集资金用途项目具体情况
变更募集资金投资项目具体情况详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的理由
1、经公司第九届董事会2016年第五次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了充分利用公司现有厂房和加快LED封装及应用产品升级,进一步增强LED封装的综合竞争力,公司拟将“信达光电LED封装及应用产品”项目中的“新建LED封装及应用产品生产线”项目变更为“新建4条LED封装及应用产品生产线”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

2、经公司第十届董事会2017年第二次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

3、经公司第十届董事会2017年第三次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

4、经公司第十届董事会2017年第四次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

5、经公司第十届董事会2017年第五次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

6、经公司第十届董事会2017年第六次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

7、经公司第十届董事会2017年第七次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

8、经公司第十届董事会2017年第八次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

9、经公司第十届董事会2017年第九次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

10、经公司第十届董事会2017年第十次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

11、经公司第十届董事会2017年第十一次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

12、经公司第十届董事会2017年第十二次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

13、经公司第十届董事会2017年第十三次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

14、经公司第十届董事会2017年第十四次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

15、经公司第十届董事会2017年第十五次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

16、经公司第十届董事会2017年第十六次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

17、经公司第十届董事会2017年第十七次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

18、经公司第十届董事会2017年第十八次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

19、经公司第十届董事会2017年第十九次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

20、经公司第十届董事会2017年第二十次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

21、经公司第十届董事会2017年第二十二次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

22、经公司第十届董事会2017年第二十三次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

23、经公司第十届董事会2017年第二十四次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

24、经公司第十届董事会2017年第二十五次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

25、经公司第十届董事会2017年第二十六次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

26、经公司第十届董事会2017年第二十七次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

27、经公司第十届董事会2017年第二十八次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

28、经公司第十届董事会2017年第二十九次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

29、经公司第十届董事会2017年第三十次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

30、经公司第十届董事会2017年第三十一次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

31、经公司第十届董事会2017年第三十二次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

32、经公司第十届董事会2017年第三十三次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

33、经公司第十届董事会2017年第三十四次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

34、经公司第十届董事会2017年第三十五次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

35、经公司第十届董事会2017年第三十六次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

36、经公司第十届董事会2017年第三十七次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

37、经公司第十届董事会2017年第三十八次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

38、经公司第十届董事会2017年第三十九次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

39、经公司第十届董事会2017年第四十次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 最初投资成本, 会计减值准备, 期末账面价值, 公允价值变动损益, 本期公允价值变动损益, 报告期损益, 期末公允价值, 会计减值准备, 资金来源.

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-18

厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一九年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)现将二〇一九年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

2013年非公开发行股票募集资金已于2018年12月31日完成使用。截至2019年3月29日,相关募集资金专项账户全部销户完毕。具体情况详见《厦门信达股份有限公司关于募集资金使用的进展公告》,刊载于2019年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以下报告内容为公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金总额扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,278,147,028.63元,已于2016年1月26日到位,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了【2016】京会验字(2016)第0200007号验资报告。

(二)募集资金使用及节余情况
截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

Table with 7 columns: 项目名称, 专户银行名称, 初始存放金额, 利息收入, 现金留存, 已使用金额, 补充流动资金, 节余金额.

注:1、补充流动资金中已使用金额超出初始存放金额部分的55.00元为支付银行帐户管理费形成,存储余额22,112.67元为募集资金产生的利息,已于2020年1月31日前全部转入一般帐户使用。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和交易所要求,结合实际情况修订了《募集资金使用管理制度》。

2016年1月9日,公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日,募投项目实施主体、公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议》(范本)不存在差异。截至2019年12月31日,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金余额为22,112.67元。

单位:元

Table with 5 columns: 专户银行名称, 账号, 余额, etc.

注:截至2019年12月31日,2015年非公开发行股票募集资金使用完毕,存储余额22,112.67元为募集资金产生的利息;截至2020年1月31日,2015年非公开发行股票募集资金专户余额全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(一)募集资金使用计划变更情况
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。

(三)募集资金投资项目实施方式变更情况
不适用。

(四)募集资金先期投入及置换情况
(五)募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用。

(六)募集资金投资项目实施主体变更情况
(七)募集资金投资项目实施主体变更情况
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截至2019年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项,募集资金余额22,112.67元已于2020年1月31日前全部转入一般帐户使用。

(九)募集资金使用其他情况
本报告期,公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

4、变更募集资金用途使用情况
(一)变更募集资金用途项目具体情况
变更募集资金投资项目具体情况详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的理由
1、经公司第九届董事会2016年第五次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了充分利用公司现有厂房和加快LED封装及应用产品升级,进一步增强LED封装的综合竞争力,公司拟将“信达光电LED封装及应用产品”项目中的“新建LED封装及应用产品生产线”项目变更为“新建4条LED封装及应用产品生产线”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

2、经公司第十届董事会2017年第二次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

3、经公司第十届董事会2017年第三次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

4、经公司第十届董事会2017年第四次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

5、经公司第十届董事会2017年第五次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

6、经公司第十届董事会2017年第六次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

7、经公司第十届董事会2017年第七次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

8、经公司第十届董事会2017年第八次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达光电LED封装及应用产品”项目变更为“信达光电LED封装及应用产品”项目,并新增LED封装及应用产品生产线项目。

9、经公司第十届董事会2017年第九次临时股东大会审议通过,《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品”项目的募集资金投资金额为61,814,700元。为了提升公司LED封装及应用产品竞争力,增强公司整体解决方案